

# Slovo úvodem - IMAPS flash Conference 2018

Pondělí, 26 Listopad 2018 00:00 | Napsal uživatel Administrator

Vážený čtenáři,

ve dnech 25. a 26. října 2018 se konala mezinárodní konference **IMAPS flash Conference 2018**. Konference byla pořádána společností IMAPS CZ&SK ve spolupráci s CEITEC a byla tématicky zaměřena na oblasti související s oblastí působnosti pořadajících společností, tj. Microelectronics Assembly, Packaging & 3D Structures, Soldering & Chip Attachment, Simulation & Testing, Sensors & Nanostructures. Ve spolupráci s organizátory konference přinášíme výběr příspěvků z této konference.



Jako nejzajímavější byly vybrány následující příspěvky:

- [Thick Film Structure – Influence of Pattern Geometry](#)
- [Analysis of thermomechanical stress on printed circuit board](#)
- [Simulation is not only the software](#)
- [Influence of Paste Viscosity on Precision of Thick Film Printing](#)
- [Chladienie so softvérovou podporou](#)
- [Method for qualification cleaning of electronic assemblies, validation of process changes in cleaning process](#)
- [Photovoltaic single cell energy harvesting](#)
- [Resistance and Nonlinearity of Current-Voltage Characteristic of Conductive Adhesive Joints with Isotropic Conductivity: Tunnel Theory](#)

- [SIMCENTER, engineering complex products from Siemens PLM Software for electronic cooling](#)
- [Digitalisation and networking in “smart production”](#)
- [System for automated solar cells characterization, SPICE modelling and simple energy harvester module application](#)
- [Design of System-on-Chip \(SoC\) with Embedded Cryptographic Module for Internet-of-Things \(IoT\)](#)
- [Hybridization of natural inorganic materials \(natural minerals\) by carbon nanotubes](#)
- STUDIO GRADE HYBRID MICROPHONE PREAMPLIFIER FOR PROFESSIONAL USE
- Raman Spectroscopy Used to Assess the Temperature and Mechanical Stress in Thin Films of Microelectronic Structures

za redakci

František Steiner